

证券代码：688037 证券简称：芯源微 公告编号：2021-002

沈阳芯源微电子设备股份有限公司 关于拟签署投资协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

● 沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“芯源微”或“公司”）拟在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区竞拍土地，建设芯源微临港研发及产业化项目。本次投资涉及的项目土地使用权的取得需要通过挂牌出让方式进行，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。

● 本次投资涉及的项目投资金额、建设周期以及实施进度尚存不确定性，公司将根据公司战略规划、经营计划、资金情况分步实施。后续具体项目投资进展情况，公司将按照有关法律法规，及时履行相应的决策程序及信息披露义务。

● 本次投资存在一定的市场风险和经营风险，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险，但不会对公司目前经营产生重大影响。

● 本次对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组事项。本次投资尚需提交公司股东大会审议。

2021年1月15日，公司召开第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司拟签署投资协议的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理临港投资相关事宜的议案》，公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责本次投资相关事宜，相关议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、协议签署情况概述

公司为提升高端半导体设备国产化步伐，完善公司的产业链布局，提高半导

体设备的设计、制造能力，拟与中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会（以下简称“临港新片区管委会”）、上海闵联临港联合发展有限公司签署《项目投资协议》，建设芯源微临港研发及产业化项目。公司将充分利用临港新片区集成电路产业集群优势，吸引、培养一批具有国际水平的骨干人才，进一步扩充产品线和生产能力，做好公司中长期发展的战略布局。

就本次投资，公司将根据公司战略规划、经营计划、资金情况分步实施，投资主体为本公司在临港新片区新设立的子公司。

本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

1、中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会

临港新片区管委会是上海市人民政府的派出机构，负责具体落实临港新片区各项改革试点任务，承担临港新片区经济管理职责，统筹管理和协调临港新片区有关行政事务。临港新片区将对标国际上公认的竞争力最强的自由贸易园区，在适用自由贸易试验区各项开放创新措施的基础上，实施具有较强国际市场竞争力的开放政策和制度，加大开放型经济的风险压力测试，实现新片区与境外投资经营便利、货物自由进出、资金流动便利、运输高度开放、人员自由执业、信息快捷联通。

地址：上海市浦东新区申港大道 200 号

公司与临港新片区管委会不存在关联关系。

2、上海闵联临港联合发展有限公司

上海闵联临港联合发展有限公司是国家级开发区上海闵行经济技术开发区根据上海市委、市政府“开发临港、决战临港”的战略决策和战略部署，由上海闵行联合发展有限公司和上海临港经济发展（集团）有限公司共同投资组建，负责国家级上海闵行经济技术开发区临港园区的投资开发建设主体，具体实施土地前期开发与各项配套基础设施建设、招商引资、推进土地出让方案编制与申请供地，并配合政府对出让地块及投资项目进行全生命周期管理和服务。

地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区旭日路 501 号

公司与上海闵联临港联合发展有限公司不存在关联关系。

三、协议主要内容

（一）协议主体

甲方：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会

乙方：沈阳芯源微电子设备股份有限公司

丙方：上海闵联临港联合发展有限公司

（二）项目选址

芯源微临港研发及产业化项目选址在上海闵行经济技术开发区临港园区内，地块规划编号 J12-03 中的 45 亩近飞渡路侧土地，目标地块精确位置、四至范围、土地面积、容积率、建筑密度、建筑限高和绿地率以乙方和政府土地管理部门签署的《上海市国有建设用地使用权出让合同》为准。

（三）各方的主要权利与义务

1、甲方

在乙方履行其在本协议及后续协议项下义务、承诺及责任的前提下，甲方将积极支持乙方项目在经认定的范围内享受临港地区政策，主要扶持如下：

（1）在符合战略新兴产业扶持要求的前提下，甲方向乙方提供核定项目总投资额一定比例的扶持资金。

（2）甲方支持乙方开展符合新片区产业发展导向的技术研发，可给予核定研发总投入一定比例的资金扶持，具体可依照各研发专项进行申报，并按评审结果确定的扶持比例予以拨付。

（3）甲方承诺给予乙方一定的税收优惠、人才政策支持。

2、乙方

（1）乙方在目标地块内从事本项目的生产经营业务。

（2）乙方承诺将尽最大努力完成协议约定的相关经济指标。

3、丙方

（1）丙方协助乙方完成环评、工商注册等行政手续，便于项目的高效推进。

（2）丙方将以乙方项目落地为契机，支持甲方整合其相关产业的上下游产业链，引导关联企业落户临港新片区，给予后勤保障、公共服务并积极协助乙方项目在经认定的范围内享受临港新片区相关政策。

四、本次投资对公司的影响

本次投资符合国家政策以及公司的战略发展需要,有利于完善公司的产业布局,能够巩固公司的核心竞争力,有助于公司中长期发展。

本次投资资金来源为公司自有或自筹资金,并将按照项目资金实际需求分批落实到位,不影响现有主营业务的正常开展,不会对公司的经营成果产生重大影响,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

五、本次投资的风险分析

考虑到未来市场和经营情况的不确定性,本次投资存在一定的市场风险和经营风险,如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化,项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险,但不会对公司目前经营产生重大影响。

本次投资涉及的项目土地使用权的取得需要通过挂牌出让方式进行,土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。

本次投资涉及的项目投资金额、建设周期以及实施进度尚存不确定性。后续具体项目投资进展情况,公司将按照有关法律法规,及时履行相应的决策程序及信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会

2021年1月16日